

捷报频传，迈为股份晶圆级混合键合设备实现批量交付

7月15日，迈为股份自主研发的全自动晶圆级混合键合设备成功交付国内新客户，这是公司在半导体领域达成的又一重要合作。此次再度获得市场认可，充分验证了该款设备在精度、稳定性和可靠性等方面的卓越性能。

本次交付的设备将助力客户构建高效、先进的半导体产线，显著优化产品制造成本，提升市场竞争力。

未来，公司将继续致力于半导体核心设备的研发创新，紧密围绕客户需求，持续提升设备性能与工艺解决方案，赋能半导体产业升级。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/230802.html>